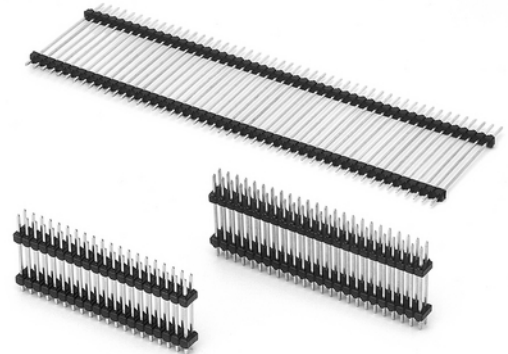


# 149 / 150 / 151

## Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-/3-reihig Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, 1/2/3 Rows

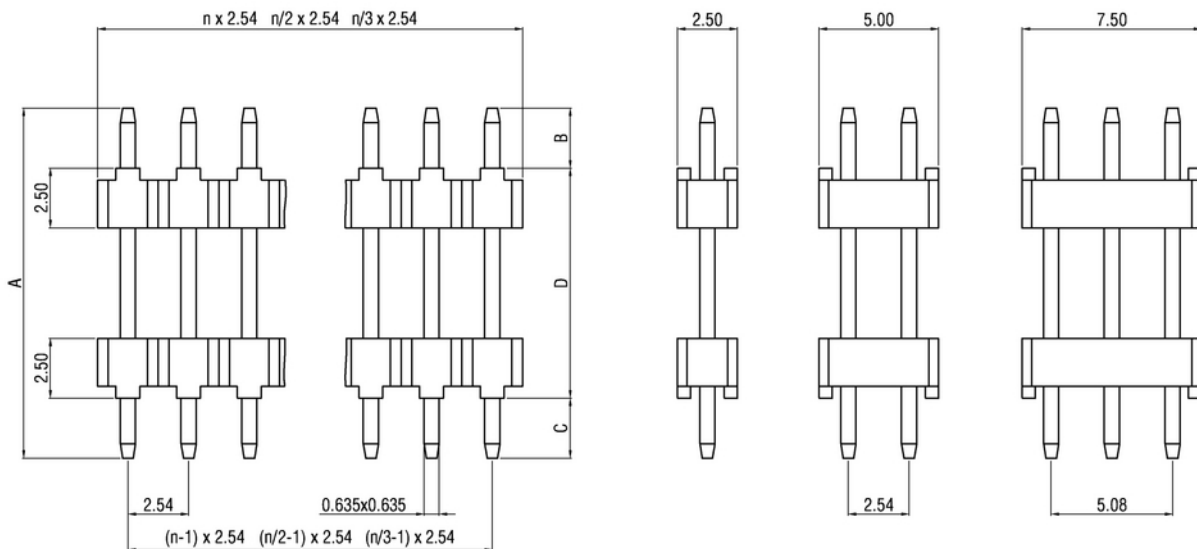
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	0.635mm square pin, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	1kV <sub>DC</sub>
Test Voltage	1kV <sub>DC</sub>
Nennspannung	250V <sub>AC</sub>
Voltage Rating	250V <sub>AC</sub>
Nennstrom	3A
Current Rating	3A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
Mate with Female Headers:  
**153 154 340 348 624** etc.  
Weitere siehe Kapitel B  
Please see ch. B for more



### Series\*

**150**

**Thermisch gerissene Kontakte**  
*Electro-strictioned contacts*  
**149** Einreihig  
*Single row*  
**150** Zweireihig  
*Double row*  
**151** Dreireihig  
*Triple row*

### Dimensions\*

**19**

**16** A=17,70 B=5,70 C=3,30 D=8,70mm  
**17** A=19,80 B=5,70 C=3,30 D=10,80mm  
**18** A=21,60 B=5,70 C=3,30 D=12,60mm  
**19** A=22,80 B=5,70 C=3,30 D=13,80mm  
**20** A=24,90 B=5,70 C=3,30 D=15,90mm  
**21** A=26,70 B=5,70 C=3,30 D=17,70mm  
**22** A=29,00 B=5,70 C=3,30 D=20,00mm  
**23** A=30,80 B=5,70 C=3,30 D=21,80mm  
**24** A=37,80 B=5,70 C=3,30 D=28,80mm  
**25** A=40,80 B=5,70 C=3,30 D=31,80mm  
**26** A=45,30 B=5,70 C=3,30 D=36,30mm

### Contacts\*

**010**

**001-050** Einreihig  
*Single row*  
**004-100** Zweireihig  
*Double row*  
**006-150** Dreireihig  
*Triple row*

### Plating\*

**00**

**00** Vergoldet  
*Gold plated*  
**10** 0,25µm Gold  
*0.25µm gold plated*  
**30** 0,75µm Gold  
*0.75µm gold plated*  
**50** Verzinkt  
*Tin plated*  
**60** Sel. Au 0,25µm / Sn  
**80** Sel. Au 0,75µm / Sn

B, C, D nach Kundenwunsch variierbar. Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster sowie weitere Stiftlängen und Abmessungen auf Anfrage.

*B, C, D variable acc. to customers' specifications. We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5.08mm, 7.62mm, etc. and varying pitches as well as more pin lengths and dimensions on request.*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** - please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
WEBSITE www.wpro.com

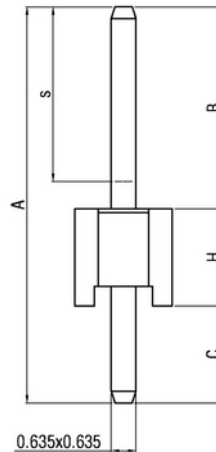
# Stiftleistenmaße und PCB Layouts für 0,635mm Vierkantstifte

## Dimensions and PCB Layouts

### Gerade Stiftleisten / Straight Pin Headers

- A : Gesamtstiftlänge / Overall Pin Length
- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

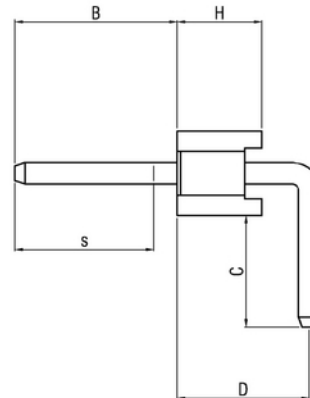
Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



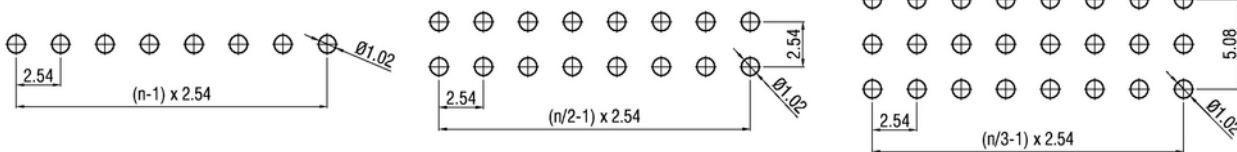
### Gewinkelte Stiftleisten / Right-Angled Pin Headers

- B : Länge Steckseite / Mating Side Length
- C : Länge Lötseite / Solder Side Length
- D : Abstand zu Steckseite / Distance to Mating Side
- H : Höhe Isolierkörper / Insulator Body Height
- s : Bereich der sel. Veredelung / Sel. Plated Area

Messpunkt für s bei 2-4mm von der Stiftspitze  
 Test point for s at 2-4mm from contact tip



### PCB Layouts



## Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

